

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2025-058

## 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

### 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503号）核准，公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）13,600,000.00 股，发行价为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 190,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00 元，余额为人民币 178,024,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,824,758.69 元，实际募集资金净额为人民币 172,199,241.31 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 11 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具报告编号为天职业字[2022]44781 号的《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	报告期内发生额
募集资金期初余额(A+B)	100,881,500.59

A 其中：募集资金储存专户活期存款余额	40,881,500.59
B 其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理	60,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	31,578.82
加：部分闲置募集资金进行现金管理收益	213,751.91
减：本年度募集资金使用金额(C+D+E)	69,830,069.09
C 其中：高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目	
D 其中：高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目之子项目“新生产线扩建项目”	19,830,069.09
E 其中：暂时补充流动资金	50,000,000.00
募集资金期末余额（F+G）	31,296,762.23
F 其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理	
G 其中：募集资金储存专户活期存款余额	31,296,762.23

## 二、募集资金管理情况

### 1. 募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司 2017 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司经董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司南陵支行 34050167620800001447、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行 521200389491000028（已销户）两个募集资金专项账户，仅用于本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### 2. 募集资金三方监管协议情况

2022年11月14日，关于向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南陵支行、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议得到了切实履行，募集资金使用得到合理监管。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	账号	账户类别	余额
中国建设银行股份有限公司南陵支行	34050167620800001447	募集资金专户	31,296,762.23
合计	-	-	31,296,762.23

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### 募投项目可行性存在重大变化

2024年5月27日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》，同意将“高端电子制造（PCBA产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造（PCBA产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施。

具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公告》（公告编号：2024-047）。

## （二）募集资金置换情况

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付的发行费用716,739.83元。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-037）。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年6月12日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于2025年6月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。

## （四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率%
雅葆轩	银行理财产品	结构性存款	6,000	2024年12月13日	2025年2月13日	浮动收益	2.07%

2024年12月25日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买理财产品，自2024年12月25日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使

用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年5月27日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》，同意将“高端电子制造（PCBA产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造（PCBA产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施。具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公告》（公告编号：2024-047）。

变更情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途投资项目名称	实施主体	实施地点	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额
1	“高端电子制造（PCBA产品）扩产项目”	公司	芜湖市南陵县经济开发区大屋路8号雅葆轩厂区内	15,363.00	532.23
2	“高端电子制造（PCBA产品）迁建项目”之子项目“新生产线扩建项目”	公司	芜湖市南陵县经济开发区G202404地块	0.00	15,363.00
合计	-	-	-	15,363.00	15,895.23

注：“高端电子制造（PCBA产品）扩产项目”变更后拟投资金额为已发生对现有厂区生产车间的装修支出；“新生产线扩建项目”拟使用14,830.77万元募集资金进行投资，不足部分通过公司自筹资金投资。

报告期内，变更募集资金用途的具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。

## 六、备查文件

- （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
- （三）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- （四）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		172,199,241.31	本报告期投入募集资金总额		19,830,069.09			
改变用途的募集资金金额		148,307,723.15	已累计投入募集资金总额		96,213,948.04			
改变用途的募集资金总额比例		86.13%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端电子制造 (PCBA 产品) 扩产项目	是	5,322,276.85		5,172,276.85	97.18%		不适用	是
高端电子制造 (PCBA 产品) 迁建项目	否	153,630,000.00	19,830,069.09	72,472,429.88	47.17%	2026 年 6 月 30 日	不适用	否

之子项目 “新生产线 扩建项目”								
补充流动资 金	否	18,569,241.31		18,569,241.31	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	177,521,518.16	19,830,069.09	96,213,948.04	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>2024年5月27日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》，同意将“高端电子制造（PCBA产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造（PCBA产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施，计划达到预定可使用状态时间由2024年12月调整到变更后的2026年6月。</p> <p>具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公告》（公告编号：2024-047）。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	<p>2024年5月27日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于</p>							

	<p>变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》，同意将“高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施。</p> <p>具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公告》（公告编号：2024-047）。</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>详见本公告之“四、变更募集资金用途的资金使用情况”。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付的发行费用 716,739.83 元。</p> <p>具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-037）。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度</p>	<p>2025 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>

	具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	50,000,000 元
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	6,000 万元，审议情况详见本公告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理情况”。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注：“高端电子制造(PCBA 产品)扩产项目”变更后拟投资金额为已发生对现有厂区生产车间的装修支出，装修已在 2023 年完成，期末投入进度未达 100%系存在尚未到期的质保金。高端电子制造(PCBA 产品)迁建项目之子项目“新生产线扩建项目”拟使用 14,830.77 万元募集资金进行投资，不足部分通过公司自筹资金投资。